

关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的关注函

创业板关注函（2021）第 520 号

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会：

2021 年 12 月 13 日，你公司披露《关于签署〈英唐半导体产业园项目之合作协议〉的公告》称，产业园项目总投资额约 25 亿元，合作内容包括设立项目公司、投资建设生产线等，项目公司将由你公司、中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司（以下简称英盟科技）合资设立。我部对此表示关注，请你公司就如下事项做出进一步说明：

1.公告显示，英盟科技将以半导体设备、知识产权作价 3.22 亿元出资取得项目公司 64.4%的股权；英盟科技成立于 2021 年 12 月 3 日，注册资本仅 300 万元，其住所与你公司相同。请补充说明英盟科技股东、团队、资产、业务、技术等的具体情况，是否属于你公司的关联方，本次作为出资的半导体设备、知识产权的具体情况及其评估情况，公司与英盟科技进行合作的主要原因及可行性。

2.公告显示，你公司以持有的上海芯石半导体股份有限公司（以下简称上海芯石）25%的股权以及货币合计出资 1.25 亿元取得项目公司 25%的股权，本次项目公司设立完成后公司直接持有上海芯石的股权份额下降至 15%，其不再纳入公司合并报表范围；公司于 2021 年 4 月以 1.68 亿元通过收购及增资取得上海芯石合计 40%的股权。请补

充说明公司对本次项目公司出资前后上海芯石纳入合并报表范围与否的判断依据，你公司取得上海芯石控制权又在短期内处置的原因及合理性。

3.请结合项目公司的股权结构、董事会构成、投资决策议事规则等补充说明项目公司的控制权认定情况。

4.根据公告，项目公司成立后将分三部分投资建设生产线，包括封测生产线、FAB 6 英寸特色工艺线等，其中第一、第二部分投资额约 2.2 亿元、18.1 亿元，第三部分投资额暂未明确。

(1) 请补充说明本次投资事项的筹划、决策过程、投资决策是否审慎，项目的资金筹措、技术储备、人才储备、管理机制、客户资源、市场需求、行业竞争力等情况，结合合作各方的经营现状、行业背景、资源条件、资金实力、资信状况等补充说明投资项目的可行性，并说明项目设计产能的制定依据及合理性。

(2) 本次项目建设主要为集成电路制造相关生产线，请补充说明本次投资是否需要取得相关行业主管部门的事先审批意见等，如是，请就可能存在的审批风险进行提示。

5.根据公告，公司自 2019 年开始向上游半导体芯片领域延伸，拟发展成为集研发、制造、封测及销售为一体的全产业链半导体 IDM 企业，但在核心的制造产能领域目前仅有子公司英唐微技术有限公司（以下简称英唐微技术）可以提供月产 5000 片 6 英寸晶圆的器件生产能力，整体规模偏小。最近一期末，你公司货币资金余额为 4.51 亿元，资产负债率为 56.38%。

(1) 请补充说明 2019 年以来你公司在半导体芯片研发、制造、封测及销售各环节的投入、产出情况，英唐微技术自收购以来的经营情况、客户开拓、市场需求增长情况及各期主要财务数据，公司本次拟扩展半导体芯片制造、封测业务的可行性、可能面临的经营风险、财务风险等，公司拟采取的应对措施。

(2) 请补充说明本次投资事项是否将对公司的生产经营构成重大影响，本次投资事项是否需提交股东大会审议，审议程序是否合规。

6.请补充说明最近三年公司的重大投资项目、框架性协议等的主要内容、实际执行情况，是否和预期情况存在差异，如是，请说明无后续进展或进展未达预期的具体情况及原因。

7.补充说明本次合作协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5% 以上股东、董监高人员的持股变动情况，以及前述人员未来三个月内的股份减持计划。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 12 月 22 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司管理部

2021 年 12 月 17 日